

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2026年6月4日、6月5日、6月10日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、中邮证券、上海胤胜资产、诚通基金、国寿安保基金、中信建投基金、华商基金、新华基金、混沌投资、平安基金、华泰资产、招商证券、北京丰汇投资、杭州安嘉昊实业控股、泓德基金、嘉实基金、国海富兰克林基金、拾贝投资、广发证券、长盛基金、华福证券、泰康基金、民生加银基金、长江资管、国联民生证券、诺德基金、太保资产、富国基金、兴业证券、景顺长城基金、国联民生、兴全基金
会议时间	2026年6月4日 12:40-13:40、6月4日 15:00-16:00、6月5日 15:00-16:30、6月10日 09:00-10:30
会议地点	有研粉材会议室
上市公司接待人员	董事长：贺会军 董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 规划发展部经理：武朋 证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星
投资者关系活动	Q1：请简要介绍一下公司情况。

<p>主要内容介绍</p>	<p>A1: 有研粉材成立于 2004 年, 控股股东中国有研科技集团是国务院国资委所属中央一级企业, 有研粉材属于二级中央企业。公司业务分为四个板块。第一个板块是铜基金属粉体材料, 目前国内市占率约 30%, 主要应用于粉末冶金、金刚石工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等下游领域, 该板块的公司有有研合肥、有研重冶和境外的有研泰国、英国 Makin 公司; 第二个板块是微电子锡基焊粉材料, 目前在国内市场占有率约 15%, 国内第一, 主要应用于微电子的封装/组装, 下游领域主要为消费电子, 该板块公司有康普锡威及其山东子公司; 第三个板块是增材制造用粉体材料 (3D 打印用粉体材料) 板块, 运营的公司为有研增材及其山东子公司, 3D 打印粉体产品主要为生产工艺比较有特色的铝合金粉、高温合金粉、铜合金粉和不锈钢粉, 另外有研增材除了 3D 打印用粉体材料还生产一些高温特种粉体材料如软磁、MIM 粉等; 第四个板块是电子浆料, 与微电子锡基焊粉材料都属于微电子互连材料, 有研纳微公司的锡膏模块也属于锡粉的下游领域, 主要用于微电子的封装、半导体组装等, 新开发的产品包括纳米级铜粉、银铜粉和镍粉。此外有研纳微公司主要聚焦国家重大专项任务, 承担了未来产业的重点技术突破。</p> <p>Q2: 今年锡粉下游客户需求有什么变化? 有感受到明显增速吗?</p> <p>A2: 目前下游客户需求整体较为稳定, 公司会实时关注下游客户需求情况, 及时调整产线以满足下游需求。</p> <p>Q3: 锡粉和锡膏的技术壁垒体现在哪些方面?</p> <p>A3: 有研粉材在锡粉和锡膏领域具备较高的技术壁垒, 且两者壁垒侧重点不同。在锡粉方面, 康普锡威公司是国内少有的能生产高端锡粉的企业, 其技术壁垒主要体现在超细锡粉的球形度控制、氧含量控制等方面。在锡膏方面, 有研纳微公司具备相关技术储备, 能够生产高端锡膏产品, 技术壁垒主要体现在助焊剂配方调配以及下游客户长期认证等方面。</p> <p>Q4: 锡粉行业的竞争格局是怎样的?</p> <p>A4: 锡粉行业集中度较高, 公司凭借技术和规模优势占据领先地位。有研粉材微电子锡基焊粉材料产品的国内市场占有率排名国内第一。</p> <p>Q5: 公司 6 号以上锡粉去年销量只有十几吨是何原因?</p> <p>A5: 目前市场上用的较多的是国外供应商的产品, 国内目前能做高端锡粉的企业较少。</p>
---------------	---

	<p>Q6: 不同型号的产品出粉率一样吗? A6: 产品型号越高, 粉体越细, 产品出粉率越低。</p> <p>Q7: 公司锡粉产品的毛利率水平如何? A7: 锡粉产品的定价是原材料加加工费模式, 原材料价格上涨会拉低产品毛利率, 锡粉产品的毛利率水平普遍不高。</p> <p>Q8: 铜粉下游应用领域集中在哪些方面? A8: 铜基金属粉体材料的下游应用主要有粉末冶金、摩擦材料、电碳制品、超硬工具、催化剂、电工合金、导电材料、热管理材料等领域。</p> <p>Q9: 增材板块今年的产能有增长吗? A9: 北京增材公司产能已基本饱和, 今年可能会增加设备提高产能。山东增材基地正在建设中, 扩产后的产能能满足市场需求。</p> <p>Q10: 增材产品的定价模式是怎样的? A10: 增材产品大部分是直接定价。</p> <p>Q11: 原材料价格上涨, 对公司毛利率有影响吗? A11: 公司整体定价模式为原材料加加工费, 原材料涨价会降低产品毛利率。</p> <p>Q12: 生产应用于光模块的锡膏难度在哪? 为什么能生产的厂家这么少? A12: 综合来看, 超细锡粉制备工艺、助焊剂配方壁垒以及漫长的客户认证周期, 共同构成了光模块锡膏领域极高的护城河, 导致目前全球范围内能稳定批量供应高端光模块锡膏的厂家屈指可数, 市场仍由外资企业主导, 国内仅少数头部企业正在加速突破。</p> <p>Q13: 公司产品中与 AI 相关的有哪些? A13: 公司的散热铜粉和部分铜粉材料已成功应用于 AI 算力服务器, 目前出货量稳定。公司 3D 打印铜粉可用于 AI 服务器液冷冷板。但公司产品属于上游原材料, 下游应用情况公司不直接掌握, 具有不确定性, 敬请投资者注意投资风险。</p> <p>Q14: 公司人才流动性如何? A14: 总体来看, 公司人才流动性处于良性可控状态, 核心研发团队稳中有增, 同时通过深化机制改革主动推动人才结构优化。</p>
--	---

	<p>Q15: 3D 打印产能扩产到 4580 吨的考虑是怎样的? 产品的下游应用主要是哪些方面?</p> <p>A15: 公司新建 3D 打印粉体产业基地、扩大 3D 打印粉体产能主要基于以下几个方面: 一是当前 3D 打印市场需求持续爆发, 市场前景好, 所属公司有研增材的现有产能严重不足, 扩产是适应当前市场的必然选择; 二是 3D 打印板块是公司的战略核心方向之一, 扩产符合集团及公司战略方向, 有助于支持战新产业快速发展, 有助于提升公司整体竞争力水平。公司扩产是基于以上因素作出的审慎决定, 能够助力公司发展增材制造粉末材料业务板块, 实现公司产业布局新增长。目前公司销售的 3D 打印粉体材料主要应用于军工、商业航天等领域, 同时民品市场也在积极拓展, 已覆盖鞋模、模具、手板等细分场景。</p> <p>Q16: 钢泰、爱法公司外采我们的产品吗?</p> <p>A16: 康普锡威公司是钢泰、爱法外采的第一供应商。</p> <p>Q17: 公司如何改善产品毛利率不高的现状?</p> <p>A17: 公司目前大宗的主要产品定价模式是原材料加加工费, 原材料价格上涨, 成本也随之上涨, 毛利率降低。公司主要通过改善产品结构、研发高附加值产品改善这一现状, 如新型散热铜粉目前已成功应用于华为昇腾 910B 芯片, 供货稳定; 电子级氧化铜粉下游应用于 PCB、催化剂等领域; 3D 打印板块的大部分产品由于其复杂工艺也按产品定价。</p> <p>Q18: 锡粉和锡膏年产能多少?</p> <p>A18: 锡粉年产能约 5000 吨, 锡膏年产能约 1000 吨。</p> <p>Q19: 公司如何看待下游光模块的起量?</p> <p>A19: 公司 2025 年 6 号及以上型号锡粉产品销量共十几吨。由于半导体封装行业集成化程度越来越高, 电子元器件越来越向软小轻薄方面发展, 行业对粉体的性能要求也会越高。如果未来下游需求出现大规模爆发, 可能会影响锡粉产品的整体结构, 公司会紧密关注下游需求情况做出反应。</p> <p>Q20: 公司锡膏产品的下游客户主要是哪些领域?</p> <p>A20: 公司锡膏产品的下游客户主要集中在光伏领域。</p> <p>Q21: 公司不同型号的锡粉产品的应用领域有差异吗?</p> <p>A21: 公司的 4 号粉略偏低端, 下游客户主要集中在传统的消费电子、半导体、家电等领域, 这部分占比最高。5 号粉主要用于手机等消费电子领域。6 号粉及以上则主要用于先进半导体封装等领域。</p>
--	---

	<p>Q22:泰国公司经营情况如何? 其下游客户是哪些领域?</p> <p>A22:泰国公司于 2024 年 6 月正式投产, 由于前期客户导入时间长、验证周期久, 前期产能释放速度较慢。随着公司产能稳步释放, 泰国基地已逐渐显现出一定的成本优势及战略价值。目前已有客户稳定下单, 不断有新客户主动接洽, 商务洽谈稳步推进。预计未来形成规模效应后能够为公司贡献更多利润。泰国公司的客户大部分是粉末冶金领域, 多集中于欧洲、东南亚和北美地区。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单 (如有)	
日期	2026 年 6 月 12 日